

总体判断拟开设专业是否可行

是 否

理由：

2022年7月16日，德州学院组织召开“半导体材料工程”专业专家论证会，专家组听取了专业建设的相关汇报，经过质询和讨论，形成意见如下：

1. 《关于加强经济社会发展重点领域急需学科专业建设和人才培养的指导意见》中明确要求：集成电路领域列入国家重点支持的学科专业设置清单。半导体材料工程专业是集成电路领域的重要支撑，该专业符合国家半导体产业发展战略、山东省半导体产业布局和德州地方社会经济发展需要，以集成电路用半导体材料制造为核心，以培养适应国家新时代工程技术发展的应用型人才为目标，突破传统专业设置界限，按照“厚基础、重应用、强实践”的基本思路，建设半导体材料特色行业专业，为半导体产业基础研究及产业行业发展提供应用型人才；
2. 半导体材料工程新专业依托原有材料化学专业和半导体产业学院，联合校内的应用数学、材料物理与化学、生物物理、机械制造及其自动化、微电子学与固体电子学等优势学科，资源共享、交叉融合，具备了建设半导体材料工程专业的办学基础和条件；
3. 师资队伍学术水平高、结构合理、教学经验丰富、实践能力强，可为专业建设提供有力的师资保障；
4. 拥有山东省硅单晶半导体材料与技术重点实验室、山东省集成电路用功能材料工程研究中心、德州市功能材料合成与性能分析测试技术工程研究中心等省市级科研平台。拥有与山东有研半导体材料有限公司等共建的半导体产业学院，为人才培养提供了良好的实践条件；
5. 半导体材料工程专业的培养方案合理，培养目标明确，课程设置科学，教学质量保障体系完善，体现了该专业的特色及优势，能够满足和支撑培养未来半导体材料应用型人才的要求。

专家组一致认为，半导体材料工程专业的建设方案可行，同意通过论证。

拟招生人数与人才需求预测是否匹配

是 否

本专业开设的基本条件是否

教师队伍

是 否

符合教学质量国家标准

实践条件

是 否

经费保障

是 否

专家签字：

赵岩

刘鹤芳 杨帆

张建民 陈伟